

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－戰略」。

[編纂]用途

基於[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，經扣除與[編纂]有關的[編纂]及其他估計開支後（假設[編纂]未獲行使），我們估計我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。我們擬按下文所載用途及金額動用[編纂]。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於支持AMOLED TDDI芯片的研發及優化。TDDI將顯示驅動與觸控驅動整合於同一芯片上。因此，AMOLED TDDI芯片可視為一類AMOLED顯示驅動芯片。我們計劃於2025年推出首款TDDI芯片，目標是於2027年之前TDDI產品佔我們總出貨量的50%以上，使其成為我們的核心產品之一。我們計劃在保持技術領先的同時，擴大顯示驅動芯片的產品組合，拓展其下游應用場景，從而建立多元化、多維度的產品矩陣。具體而言，我們旨在提高AMOLED TDDI芯片的性能、效率及可靠性，並於未來三年根據不斷變化的客戶需求和技術趨勢，進一步擴大其在智能手機中的應用。根據弗若斯特沙利文的資料，2024年，TDDI芯片的全球銷售量增加至1,040.0百萬顆。預期於2029年將達至1,431百萬顆，複合年增長率為6.6%。亦請參閱「業務－戰略－持續加大研發投入，推動技術創新迭代」。具體而言：
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於擴充及強化我們的研發團隊，包括支付現有團隊的員工成本，以及增聘研發工程師、實驗室工程師、產品開發工程師及現場應用工程師。我們的研發團隊負責AMOLED TDDI芯片及Micro-LED顯示背板／驅動的開發，並根據項目需求在這些產品線之間共享資源。展望未來，我們預計研發團隊的整體規模將會增加，以支援我們的產品開發路線，預計研發人員總數於2026年底將達到約200人，於2029年底將進一步增加至約300人。每個類別的預計平均每月員工成本分別約為研發工程師[編纂]港元、實驗室工程師[編纂]港元、產品開發工程師[編纂]港元及現場應用工程師[編纂]港元。在未來五年，我們的目標是通過持續擴大團隊規模，實現下一代AMOLED TDDI芯片的主要發展里程碑。這些前瞻性資料反映了我們目前的估計，並可能因我們無法控制的各種因素而發生變化。概無法保證我們的實際結果不會與這些預期大相徑庭。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作設計支出，包括與知識產權許可、技術服務及相關設計活動有關的成本。其中包括與集成電路布圖設計及芯片級電路設計有關的專利，以及補償算法專利和與顯示面板製造商合作開發的模組生產工藝優化專利。此外，於未來三年，我們計劃為維持及擴展適用於AMOLED及Micro-OLED產品的若干通用專利分配資金，如與顯示模組技術及顯示面板像素排列有關的專利，以進一步提高我們產品的競爭力。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作流片支出。流片是指將芯片設計方案交付至晶圓製造設施以進行實際晶圓生產的工藝。該等支出主要包括掩膜成本，其涵蓋FAB掩模製造，而掩模的所有權對晶圓生產中的掩模使用至關重要。探針卡成本亦包括在內，原因為該等定制工具對芯片探測測試（交付合格芯片的前提）而言至關重要。原材料成本主要與用於廣泛驗證程序以確保芯片可進行量產的晶圓有關。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於新產品驗證，包括測試及驗證成本，如測試儀費用及第三方驗證服務。第三方成本涵蓋由中立外部組織進行標準化驗證的開支，以及使用第三方機構的專業設備對瑕疵樣品進行失效分析的開支。此外，測試成本包括於進行測試程序開發及特定批次驗證的開發階段產生的成本。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於支持Micro-OLED及Micro-LED顯示背板／驅動的研發及優化。Micro-LED顯示背板／驅動與Micro-OLED顯示背板／驅動原理相似，差別在於顯示技術。相較於Micro-OLED顯示背板／驅動採用OLED像素，LED像素與顯示驅動電路被放置在硅晶圓上。由於其更長的耐久性及更高的效率，Micro-LED顯示背板／驅動適用於商業顯示器、AR/VR頭戴式裝置以及汽車顯示器等應用。我們旨在提升下一代顯示技術的技術能力，提高Micro-OLED及Micro-LED解決方案的性能、集成度和商業可行性。就技術研發而言，知識產權開發及專利保護是像素電路設計中的關鍵方面。我們已制定技術路線圖，以於未來三年開發及改進關鍵技術，包括單／串聯EL驅動及高PPI設計。受下游XR設備需求推動，全球Micro-OLED顯示背板／驅動銷售量呈現出顯著增長，從2020年的60萬片增長到2024年的250萬片，複合年增長率為41.1%。預計到2029年，全球Micro-OLED顯示背板／驅動市場銷售量將繼續呈現上升趨勢，達到2,670萬片，複合年增長率為60.6%。亦請參閱「業務－戰略－持續加大研發投入，推動技術創新迭代」。具體而言：
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來三年擴大及加強我們的研發團隊，包括支付現有團隊的員工成本以及聘請研發工程師、實驗室工程師、產品開發工程師及現場應用工程師。由於我們的研發人員同時支援AMOLED與Micro-OLED的產品開發，因此不同類別工程師的預計人數增長與每月平均員工成本一致。上述預測乃基於我們目前的估計，並可能會視實際營運需求而改變。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作設計支出，包括與知識產權許可、技術服務及相關設計活動有關的成本。其中包括Micro-OLED顯示的像素電路設計專利。此外，於未來三年，我們計劃投資AR/VR等新產品線的系統級專利，包括涵蓋數據傳輸協議及顯示驅動模式的專利，以確保我們的產品於下一代顯示應用中的競爭力。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作流片支出，包括掩膜生產、探針卡成本及原材料等晶圓製造開支。核心工藝仍與流片階段的AMOLED TDDI芯片的芯片生產一致。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於新產品驗證，包括測試及驗證成本，如測試儀費用及第三方驗證服務。該等成本與AMOLED TDDI芯片驗證一致。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於戰略投資或收購，以把握未來發展機遇。相關投資將主要針對顯示驅動芯片產業價值鏈的上下游參與者，以配合我們的長期擴張計劃。具體而言，我們打算投資或收購擁有成熟的顯示驅動芯片產品、客戶群及銷售渠道的公司，以加快新興業務的發展，拓展至新的市場及應用場景。我們亦計劃對代工廠等上游參與者進行戰略性投資，以深化與這些合作夥伴的關係並確保充足產能。根據弗若斯特沙利文的資料，基於供應鏈安全考量，像我們這樣的fabless芯片設計公司對代工廠進行戰略性股權投資實屬常見。此外，我們將繼續探索潛在的投資或收購下游參與者（例如顯示面板製造商或模組公司）的機會，前提是有關投資在商業上可行。這將進一步鞏固我們在價值鏈中的地位，並增強我們服務終端客戶的能力。截至最後實際可行日期，我們尚未選定任何具體投資或收購目標。目前，我們預期在未來三年內將進行數目有限的戰略性投資或收購，主要目標為顯示驅動芯片行業價值鏈的上下游參與者，以配合我們在「業務－戰略」中所述的長期擴張計劃。在選擇投資或收購目標時，我們擬採用標準化的篩選準則，其中包括：(i)業務規模及營運往績記錄；(ii)地理覆蓋範圍及市佔率；(iii)技術能力、知識產權組合及產品管線；(iv)已建立的客戶基礎及銷售渠道；及(v)穩定收入及持續盈利能力的往績記錄。

預期該等戰略性投資或收購將透過強化我們的上游供應鏈安全及擴大我們的下游客戶範圍，與我們的現有營運產生協同效應。截至最後實際可行日期，我們尚未識別或與任何特定投資或收購目標進行討論。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於營運資金及其他一般企業用途，包括日常營運及一般企業開支。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得額外的[編纂]淨額[編纂]港元。

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用於上述用途，或倘我們無法按計劃實施未來發展計劃的任何部分，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守香港上市規則項下的適當披露規定。